

7

6

5

4

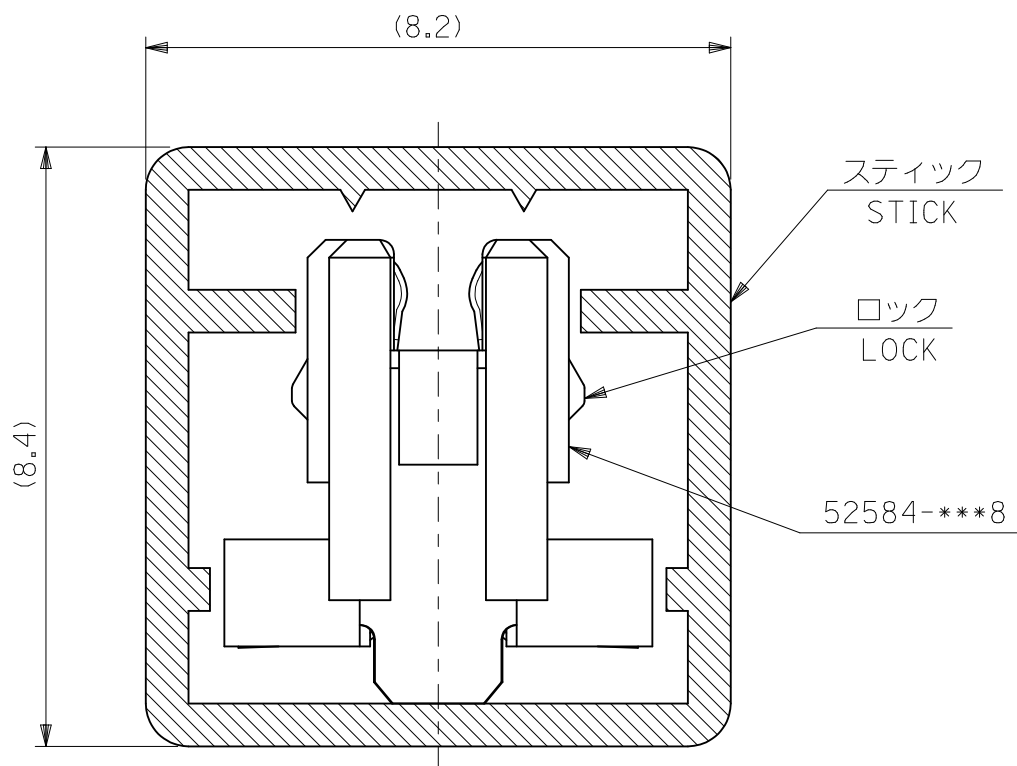
3

2

1

注記 NOTES

- スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
- 全 長: 600 ± 2
TOTAL LENGTH
- 肉 厚: 0.6 ± 0.2
THICKNESS
- ロックは、20, 34, 50極に設置。
LOCK TO BE ADDED TO 20, 34
AND 50 CKTS.
- 本製品は52584-***9の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52584-***9.



7	52584-1479	140
8	52584-1279	120
10	52584-1079	100
12	52584-0879	80
15	52584-0679	60
18	52584-0579	50
梱包数 QUANTITY	MATERIAL No.	極数 NO. OF CKTS

MATERIAL

スティック : ポリ塩化ビニル
STICK : P.V.C

REVISED

EC NO: J2011-1534
DRWN: TKAKIMOTO 2011/05/18
CHKD: THARUYAMA 2011/05/18
APPR: HIRATA 2012/06/07

QUALITY
SYMBOLS

CRITICAL

MAJOR

ZERO DEFECT

S.P.C.

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)DIMENSIONS $\pm$ ---ANGULAR $\pm 3^\circ$

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE
MM ONLY

DRAWN BY
HKAWABATA

DATE
'04/03/22

CHECKED BY
KTOJO

DATE
'04/03/22

APPROVED BY
MSASAO

DATE
'04/03/22

MATERIAL NO.

SCALE
---DESIGN UNITS
METRICTHIRD ANGLE
PROJECTION

52584-***8
STICK PACKAGING
-LEAD FREE-

molex

SEE TABLE

DOCUMENT NO.

SD-52584-008

SHEET NO.

1 OF 1

6

5

4

3

2

F

E

D

C

B

A

F

E

D

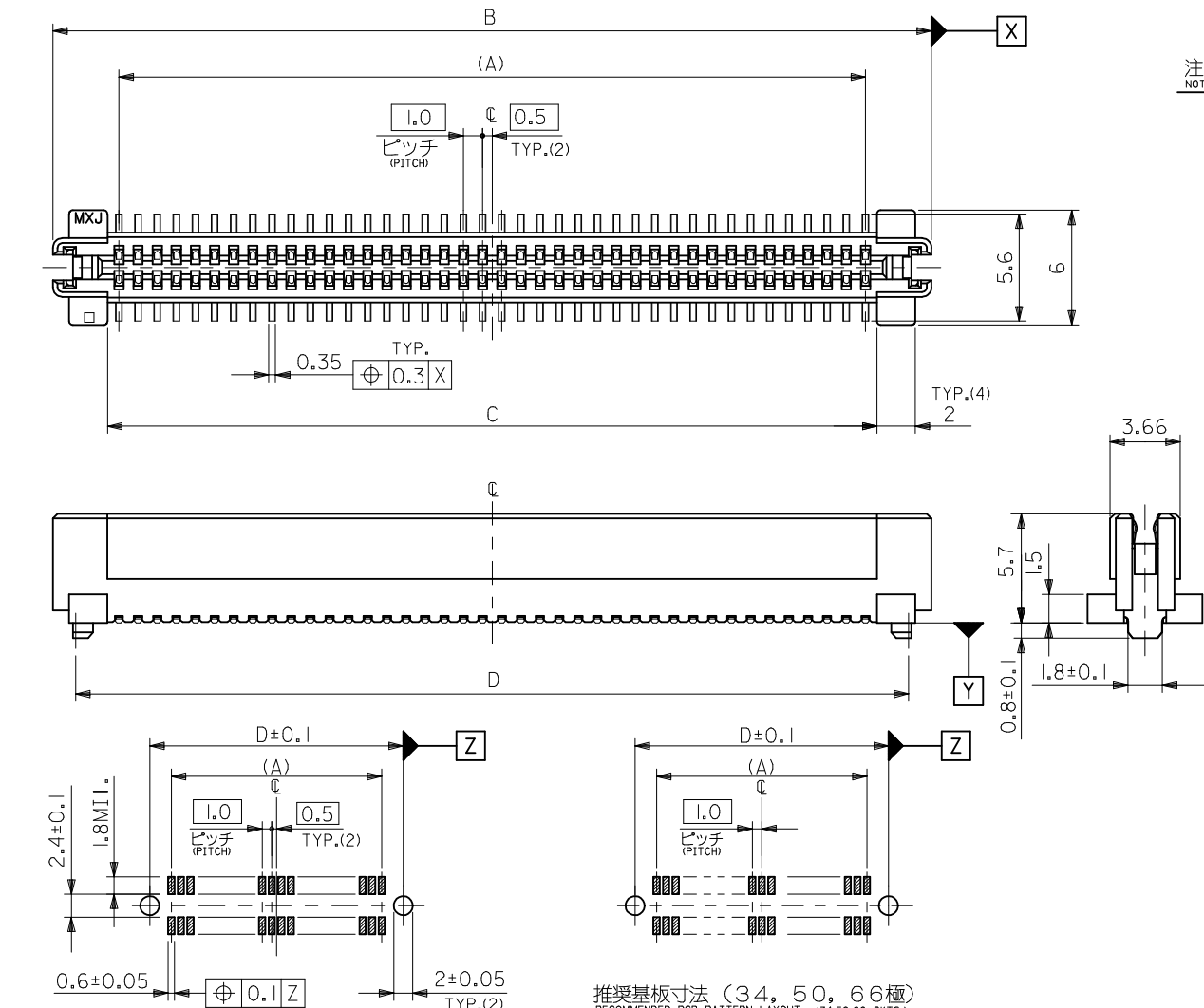
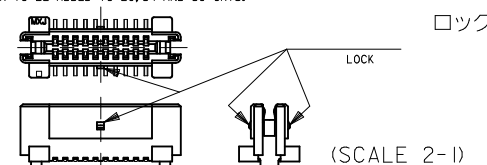
C

B

A

注)
NOTES

1. 材質
MATERIAL
ハウジング: ガラス入り LCP、白色、UL 94V-0
HOUSING: G.F.LCP, WHITE, UL 94V-0
ターミナル: 燐青銅 (t = 0.2)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE
2. メッキ仕様
PLATING
接点部: 金メッキ 0.25 μm MIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.25 μm MIN.
半田付け部: 半田メッキ 1.0 μm MIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD 1.0 μm MIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 2.0 μm MIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 μm MIN.
3. 推奨基板厚
RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.0 ± 0.1 mm MIN.
4. テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テールは、Y 面を基準とし、上へ 0.02 下へ 0.15 の範囲にあり、且つテール平坦度は 0.15 とする。
TAILS TO BE WITHIN 0.02 UPWARD AND 0.15 DOWNWARD FROM Y-DATUM PLANE, AND TAIL COPLANARITY TO BE 0.15.
5. ロックは、20、34、50 極に設置する。
LOCK TO BE ADDED TO 20, 34 AND 50 CKTS.
6. 梱包
PACKAGING
本製品はスティック梱包とし梱包後の ENG. NO. は 52584-***9 とする。
THIS PRODUCTS TO BE PACKED IN TUBE. ENG. NO.: 52584-***9
7. 同一基板内に複数個 (2 個以上) の使用は避けてください。
MXJ DOSE NOT RECOMMEND THE USAGE OF TWO OR MORE OF THESE CONNECTORS BETWEEN A SINGLE PAIR OF P.C.B.OARD.



推奨基板寸法 (20、60、80、84、100、120、140 極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (20,60,80,84,100,120,140 CKTS.)
(SCALE 2-1)

推奨基板寸法 (34、50、66 極)
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT (34,50,66 CKTS.)
(SCALE 2-1)

73.5	70.2	75.9	69	52584-1400	140
63.5	60.2	65.9	59	52584-1200	120
36.5	33.2	38.9	32	52584-0660	66
33.5	30.2	35.9	29	52584-0600	60
28.5	25.2	30.9	24	52584-0500	50
20.5	17.2	22.9	16	52584-0340	34
13.5	10.2	15.9	9	52584-0200	20
D	C	B	(A)	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.

REVISED EC NO: DRWN:YOSHIDAM CHKD:THARUYAMA APPR:THARUYAMA J	DESCRIPTION 2008/11/06 2009/03/23 2009/03/25	REV	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE		SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION			
					MM ONLY		4:1	METRIC				
			10 UNDER	±0.2	DRAWN BY J. MIYAZAWA	DATE	TITLE 1.0 B-T0-B S/T REC. HSG ASSY					
			10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE						
			30 OVER	±0.3	APPROVED BY H. IKESUGI	DATE	MOLEX INCORPORATED					
			ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.							
			DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-52584-009					
		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								